Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXP57253M
Premium CPU OBSŁ. 1024DI/O 80AI/O FIPIO



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub komponentu	Podwójny moduł procesora
Oznaczenie oprogramowania	PL7 Junior/Pro

Parametry uzupełniające

Liczba racków	16 4/6/8 sloty 8 12 slotów
Liczba slotów	96 128 64
Pojemnośc procesora WE/Wy dyskretnych	1024 WE/WY
Pojemność analogowego procesora WE/WY	80 WE/WY
Liczba zastosowań na konkretny kanał	24
Liczba kanałów sterujących procesem	10 do 30 prostych pętli
Połączenie typu zintegrowanego	Nieizolowane połączenie szeregowe 2 żeńskie mini DIN złącze (19.2 kbit/s) Manager Fipiio (127 agentów) SUB-D 9 złącze
Procesor modułu komunikacyjnego	1 moduł Fieldbus (żaden jeśli CANopen jest w użyciu) 1 moduł sieciowy 4 moduły magistrali AS-Interface 1 CANopen
Opis pamięci	Wewnętrzna pamięć RAM (z kartą PCMCIA) 64 Ksłów dane Wewnętrzna pamięć RAM (bez karty PCMCIA) 64 Kslów program i dane Karta PCMCIA 160 Kslów program Karta PCMCIA 2688 Kslów dodatkowa przestrzeń do przechowywania danych
Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu	30.5 %MWi słów wewnętrznych lokalne dane wewnętrzne 32 %KWi słów stałych lokalne dane wewnętrzne 8132 %Mi lokalne bity wewnętrzne
Struktura aplikacji	1 zadanie główne 64 zdarzeń zadaniowych 1 szybkie zadanie
Czas wykonania na instrukcję	0.19 µs Boole'owski bez karty PCMCIA 0.21 µs Boole'owski z kartą PCMCIA 0.25 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa bez karty PCMCIA 0.42 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa z kartą PCMCIA 2.6 µs zmienne punkty z kartą PCMCIA 2.6 µs zmienne punkty bez karty PCMCIA
Liczba rozkazów na ms	2.5 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka z kartą PCMCIA 3.57 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka bez karty PCMCIA 3.7 Kinst/ms 100 % Boole'owski z kartą PCMCIA 4.76 Kinst/ms 100 % Boole'owski bez karty PCMCIA
Układ napowietrzny	0,35 Ms dla szybkie zadanie 1,2 ms dla zadanie nadrzędne
Oznakowanie	CE

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Sygnalizacja lokalna	Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony) Aktywność w magistrali Fipio (FIP): 1 LED (czerwony) Błąd konfiguracji modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) Aktywność w porcie (TER): 1 LED (żółty)
Obciążenie prądowe	820 mA w 5 V DC
Format modułowy	Podówjny
Masa produktu	0,56 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A CSA C22.2 nr 142 IEC 61131-2 UL 508 73/23/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D 92/31/EEC 93/68/EEC
Certyfikaty produktu	GL RINA DNV LR ABS BV RMRS
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Wilgotność względna	10…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas pracy 5…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas przechowywania
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	662,0 g

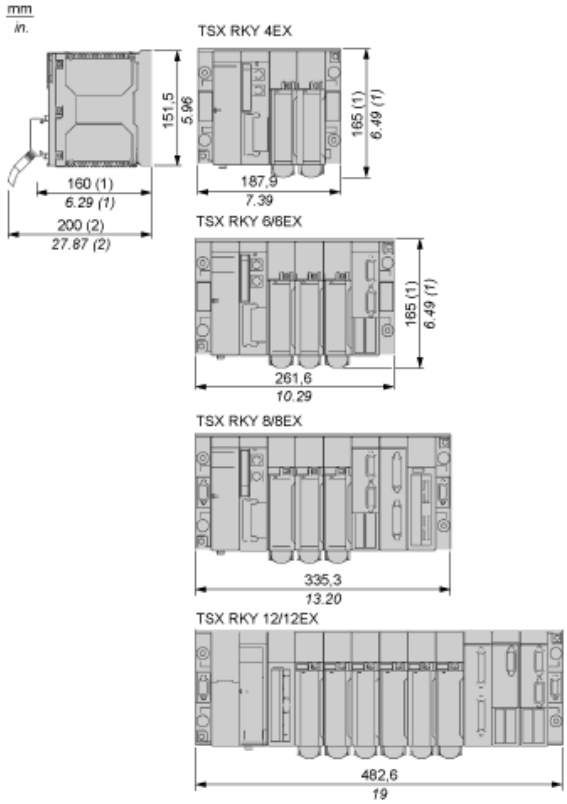
Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.